

智慧財產管理計畫及執行報告書

正凌精密工業股份有限公司

正凌精工之智慧財產權結合公司營運五大目標 MATICs 的市場布局

正凌精工(Nextron)以互連技術為核心，聚焦於 MATIC 五大應用市場：醫療(Medical)、航太/國防(Aerospace)、運輸(Transportation)、工業(Industrial)、雲端/通訊(Cloud/Communication)。正凌精工(Nextron)在累積接近四十年的專業技術與持續擴展，從基礎的連接器解決方案出發，結合多年的研究成果，持續擴充布局在整機與次系統的機電與線纜的整合，並針對 AI 應用裝置與服務水冷客戶持續擴充散熱部件的加工技術與製造能量，持續以高階機箱零組件與標準系統設計製造經驗做全球化布局。

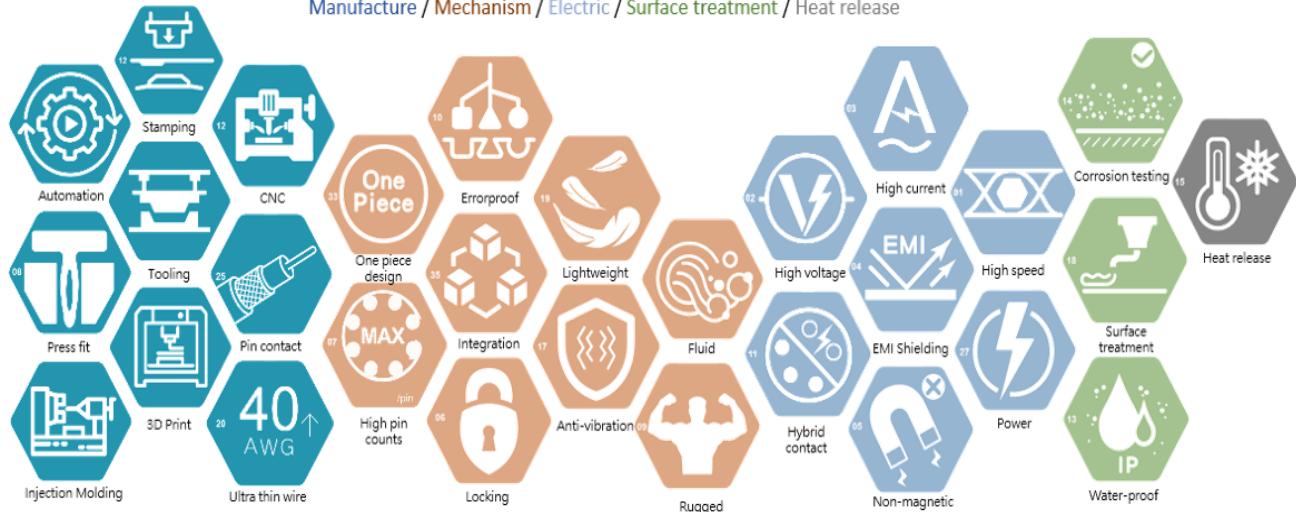
核心技術與研發策略

在 MATIC 五大應用市場中，正凌深耕高速傳輸與散熱部件、各式圓形連接器、機電與系統整合以及壓接產品與設備開發能量，發展出一系列的整合技術及客製化服務，提供互連技術的整體解決方案，成為客戶值得信賴的創新夥伴，近年積極布局有成在：AI 產業市場相關的人形機器人、CDU 模組的散熱模組零件加工、國防與無人機及液冷散熱等相關連結技術。

預計取得成效

Integrated Technology

Manufacture / Mechanism / Electric / Surface treatment / Heat release



- 在布局 MATIC 五大應用技術領域上，為妥善保護寶貴的研發成果，電子化文件管理推動公司員工在設計開發時具有專利的布局能力並具備智慧財產管理能量，使得正凌公司之專利與商標持續營運豎立品牌形象，並保障公司及客戶應有權益於商業市場上取得產品成功。

智慧財產管理政策

- 保護公司之智慧財產，強化公司在產業技術上競爭力，以確保公司永續經營。
- 同步強化專利與商標管理，提升公司員工智慧財產權管理意識，
- 持續智財管理，提高智財運用。
- 與異業結盟，對新產品領域技術進行布局。

智慧財產管理目標

- 以有價值的發明專利為主軸做申請，並輔以新型專利的速度做保護。
- 積極推動專利申請與布局。
- 結合公司營運政策，制定智慧財產管理計畫。
- 透過共同持有專利，讓產品技術客戶形成互利與共生的商業模式。

智慧財產管理措施

專利管理

- 為產生良好的研發循環，制定從產品研發到專利申請維護及運用之相關流程管理辦法，規範產品研發皆需經過審查及評估，並制定獎勵制度以鼓勵研發單位積極研發。
- 公司從事創新、發明研究產品時，參考或技術之引進，應注意不得侵害他人的專利。
- 專利申請前應由研發部門協同委任之專利法律事務所召開內部專利審查會議，經過嚴格專利比對，評估專利可行性、申請類別及區域等事項。
- 在召開會議前，發明人應先備妥相關發明文件之簡報。
- 防止專利智財侵權風險，提供專利搜索指南，以利研發單位檢索查詢相關擁有之專利資料，確保公司研發成果。
- 專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人。但契約另有約定者，從其約定。

商標管理

- 新開發之產品表面依產品材質使用合適之加工方式標示正凌商標，增加產品品牌辨識度，防止競爭對手採取不正當手段侵犯權益之行為。
- 已申請之商標定期開展商標會議，檢視各商標使用情況，使用領域是否重疊，判斷商標是否有持續維護有效性之必要。

營業秘密管理

- 機密文件管制：明確透過電子化系統管理機密文件歸檔及調閱，依照職等設定讀取權限，公司員工須調閱機密文件須填「調閱申請表」，並依規定及流程經主管核准始可行之。
- 人員管制：針對不同等級機密文件，設定新增、修改、查閱等權限。公司新進員工於入職時即簽署保密協定。
- 環境設施管制：明定管制區域與一般區域畫分。無常規權限員工、客戶及參觀人員進出管制區域時，實施登記陪同制。
- 門禁安全管制：本公司員工辦公地方皆由指紋辨識進出權限，適當門禁管理。

年度執行情形及智慧財產管理成果

年度執行情形

專利管理

- 定期彙報專利案件狀況並進行評估：每月提供公司各項專利申請及其維護報表，以利檢視已獲得專利之使用情形及其專利佈局。
- 定期檢視已獲得專利，以評估後續維護之必要性。
- 公司整體內控自評：專利管控紀錄及專利法顧諮詢紀錄納入公司整體內控自評。
- 提供不侵權聲明：依正凌所申請通過之專利，我方承諾在客戶面臨專利問題時，願意提供專利侵權分析所需技術支援，並協力進行抗辯。

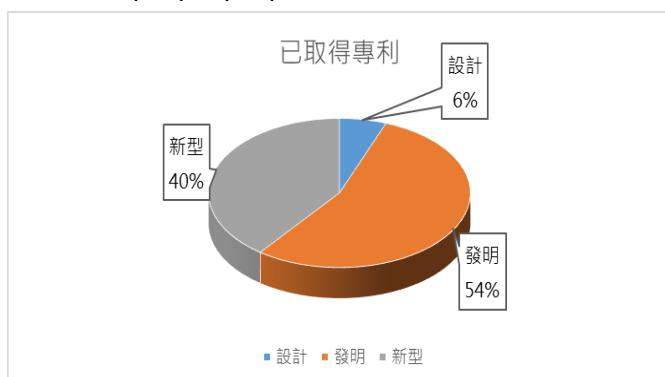
商標管理

- 定期彙報商標狀況並進行評估：每月提供公司商標申請及維護之報表，檢視已獲得商標之使用情形，評估是否需持續維護及展延之必要性。

智慧財產管理成果

專利佈局：

截至 2025 年 10 月 31 日，已取得專利 121 件，此外還有 68 件專利正在申請中。已取得專利包含美/中/台/德/日本。其中發明案佔總立案約 5 成。



2025 取得專利 (2024/11/1~2025/10/31)

項目	案件名稱	申請種類	國家	發明人
1	同心圓換電連接裝置	發明	台灣	徐志雄 / 梁燦輝 / 黃國鴻 / 熊信南
2	高速推拉自鎖連接器及連接器組合	發明	大陸	蘇侯安 / 張永 / 胡尊尊 / 孫威
3	電連接裝置	新型	大陸	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
4	儲能插座電連接器	新型	大陸	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
5	儲能插頭電連接器	新型	大陸	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
6	可旋轉快插電連接裝置	新型	大陸	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
7	高密度連接裝置	發明	大陸	陳言成 / 蘇侯安 / 徐志雄 / 孫郁婷 / 張永
8	電連接器插座的主體-母端	設計	大陸	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
9	電連接器插頭的主體-公端	設計	大陸	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
10	光模塊裝置	新型	台灣	徐志雄 / 馮景盛 / 曾定勇 / 廖小瓊
11	可插拔的連接裝置	新型	台灣	徐志雄 / 張永 / 彭劍釗
12	紡紗引線及電路板的快速連接結構	新型	大陸	蘇侯安 / 陳冠文 / 孫郁婷 / 蔡維溢 / 李利翔
13	引線及連接端子的快速連接結構	新型	大陸	蘇侯安 / 陳冠文 / 孫郁婷 / 蔡維溢 / 李利翔
14	紡紗導線及電路板的連接結構	發明	台灣	蘇侯安 / 陳冠文
15	液冷快速接頭裝置	新型	台灣	徐志雄 / 鄧志鴻 / 曾定勇 / 廖小瓊
16	鈕扣型連接結構	新型	台灣	蘇侯安 / 陳冠文 / 孫郁婷 / 蔡維溢 / 李利翔 / 許航碩
17	導線及連接端子的快速連接結構及其方法	發明	台灣	蘇侯安 / 陳冠文 / 孫郁婷 / 蔡維溢 / 李利翔
18	鈕扣型連接裝置	新型	台灣	蘇侯安 / 陳冠文 / 孫郁婷 / 蔡維溢 / 李利翔 / 許航碩
19	連接裝置	新型	台灣	蘇侯安 / 陳冠文 / 孫郁婷 / 蔡維溢 / 李利翔 / 許航碩
20	紡紗導線及電路板的連接方法	發明	台灣	蘇侯安 / 陳冠文
21	儲能插頭電連接器	發明	台灣	徐志雄 / 廖小瓊 / 鄧志鴻 / 陳國宏 / 孫威 / 徐偉
22	無極性限制的連接裝置	發明	台灣	徐志雄 / 梁燦輝
23	光模塊裝置	新型	大陸	徐志雄 / 馮景盛 / 曾定勇 / 廖小瓊
24	連接裝置及其與對接裝置的組合	發明	大陸	張永 / 梁良駒

其目前已取得專利與正凌五大目標市場的布局況如下

目標市場分類	主要布局之專利號	營業額佔比
醫療(Medical)	USD0712360S1 USD0726123S1 USD0726122S1 USD0749519S1 US09496638B1 US10224654B1 US10312620B1 US10490937B1 US10630024B1 US10644450B2 USD0903604S1 US11424566B2 US11532911B2	23.28% → 25.36%
航太/國防(Aerospace)	US10734761B1	2.06% → 3.51%
運輸(Transportation)	US11196218B1	5.04% → 2.19%
工業(Industrial)	US09677584B2 US10070549B2 US11264763B1	21.23% → 20.00%
雲端/通訊 (Cloud/Communication)	US7413449B1 US07557305B2 US07824224B2 US08197282B1 US09160090B2 US09323016B2 US09634432B2 US09520678B2 US09774143B1 US10074941B1 US10069248B2 US10186802B1 US10455739B2	48.16% → 48.37%

商標佈局：

截至 2025 年 10 月 31 日，總共取得商標 17 件，包含美中台。

智慧財產優勢與對企業營運之貢獻

- 智慧財產權透過專利共享、相互授權達成智財結盟，開拓新商機，一同創造無限的商業價值。
- 保護研發成果：專利申請可保護本公司之智慧財產，符合正凌精工(Nextron)文化之「產業技術累積」及「培養人才」。已取得之專利授權與以取得更多利益。
- 加強品牌形象：正凌精工(Nextron)已在台灣、美國、中國等多國取得商標，積極參與世界技術展，以在國外提升知名度，並提供客戶迅速、敏捷開發之品牌價值傳達至客戶心中，成為客戶優先選擇。

智慧財產風險與機會評估

若未能防止公司智慧財產權被洩漏、侵害，公司處於被動狀態，將造成極大的損失。考慮智慧財產權之內外部風險，並評估利害關係人對智慧財產管理制度之要求與期待，對此因應措施：

- 持續針對不同職責員工，定期舉辦智慧財產權教育訓練：
 - ◆ 公司新進員工：智財基本概念及組織之智財管理政策、目標及相關規定
 - ◆ 管理權責人員：智財相關法律；智財訴訟與仲裁；智財授權與契約；智財申請與延展；智財救濟方式；智財侵害鑑定；專利迴避設計；智財評價；智財之資訊安全管理
- 持續完善營業秘密管理
 - ◆ 機密文件：透過電子化管理存放，並依照職等設定讀取權限。
 - ◆ 圖面管理：透過電子化簽核流程管理圖面發行，僅開放研發單位及 DCC 權限讀取，若其他單位需求閱讀權限，在系統上開立帳號申請單，最後經由總經理核准。提供給客戶或廠商的圖面需經過簽核發行才可提供。
- 為了保護創新及研發成果，鼓勵發明創新及技術展現，且透過強化公司智慧財產布局整體專利強度，提升公司在市場上競爭力及知名度。

智慧財產管理展望

正凌精工(Nextron)重視公司治理，在未來將持續制訂與公司營運策略結合的智財管理計畫，為落實智慧財產相關之規章「公開發行公司建立內部控制制度準則」及「上市上櫃公司治理實務守則」，產出此份智財報告書並揭露於公司網站(<https://www.nextrongroup.com/zh-TW>)，使客戶投資人獲得智慧財產管理相關資訊，評估正凌精工(Nextron)之競爭力及價值。